

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年12月29日(29.12.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/270057 A1

(51) 国際特許分類:
B29C 45/02 (2006.01) H01L 21/56 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2022/012597

(22) 国際出願日: 2022年3月18日(18.03.2022)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2021-105680 2021年6月25日(25.06.2021) JP

(71) 出願人: T O W A 株 式 会 社 (TOWA CORPORATION) [JP/JP]; 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町5番地 Kyoto (JP).

(72) 発明者: 高田 準子 (TAKADA, Junko); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町5番地 T

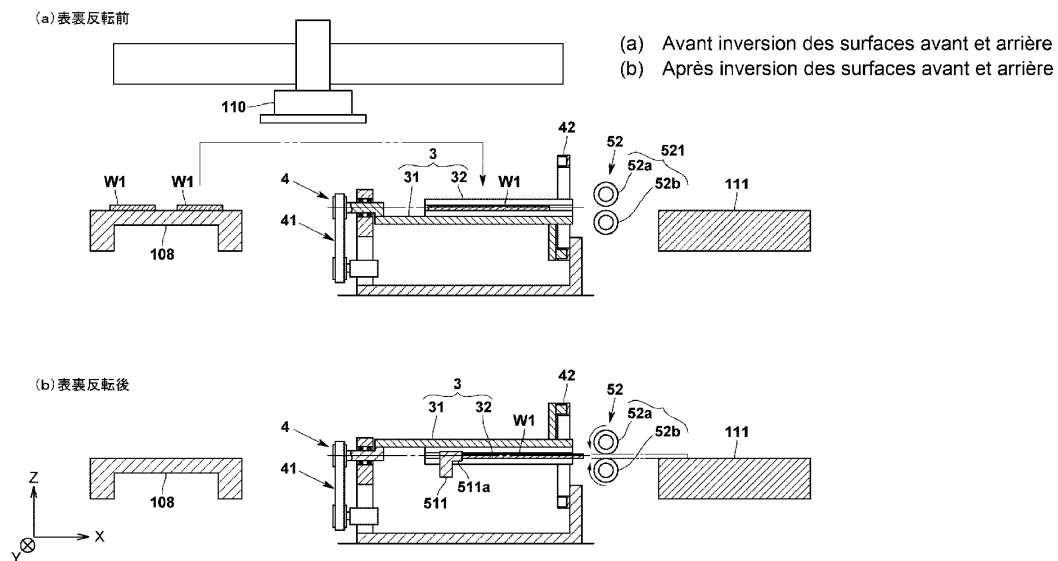
O W A 株式会社内 Kyoto (JP). 大庭 亮人 (OBA, Akito); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町5番地 T O W A 株式会社内 Kyoto (JP).

(74) 代理人: 西村 竜平, 外 (NISHIMURA, Ryuhei et al.); 〒6008441 京都府京都市下京区四条町347番地1 C U B E 西烏丸9階 Kyoto (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,

(54) Title: RESIN MOLDING DEVICE AND PRODUCTION METHOD FOR RESIN MOLDED ARTICLE

(54) 発明の名称: 樹脂成形装置、及び樹脂成形品の製造方法



(57) Abstract: The present invention is one that reduces product defects such as the inability to completely remove remaining unnecessary resin or the damaging of a package when removing unnecessary resin that remains on a sealed substrate from which unnecessary resin including at least a cull has been removed, and has a resin molding unit B that resin seals a substrate W and forms a sealed substrate W1, and removing units C, D that remove unnecessary resin K1, K2 from the sealed substrate W1. The removing unit D has an inverting and conveying mechanism 2 comprising: a substrate holding unit 3 that holds the sealed substrate W1 from which first unnecessary resin K1 including at least a cull has been

[続葉有]

QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

removed; an inverting unit 4 that causes the substrate holding unit 3 to rotate and inverts the front and back surfaces of the sealed substrate W1; and a substrate conveying unit 5 that conveys the sealed substrate W1 whose front and back surfaces have been inverted by the inverting unit 4 to a processing stage 111 for removing second unnecessary resin K2 remaining on the sealed substrate W1.

(57) 要約: 本発明は、少なくともカルを含む不要樹脂が除去された封止済基板に残存した不要樹脂を除去する場合に、残存した不要樹脂を除去しきれない又はパッケージが欠けてしまう等の製品不良を低減するものであり、基板Wを樹脂封止して封止済基板W1を形成する樹脂成形部Bと、封止済基板W1から不要樹脂K1、K2を除去する除去部C、Dとを有し、除去部Dは、少なくともカルを含む第1不要樹脂K1が除去された封止済基板W1を保持する基板保持部3と、基板保持部3を回転させて封止済基板W1を表裏反転させる反転部4と、反転部4により表裏反転された封止済基板W1を、封止済基板W1に残存した第2不要樹脂K2を除去するための加工ステージ111に搬送する基板搬送部5とを備える反転搬送機構2を有する。